



Katsunori Hirata

平田 勝則

コネクテックジャパン株式会社
代表取締役 CEO

【会社所在地】〒944-0020 新潟県妙高市工団町3-1

【事業紹介】 半導体パッケージの受託開発、受託製造事業。世界初極低温極低荷重実装技術『MonsterPAC』をコア技術にIoT実装技術革命を起こします。

CONNECTEC JAPAN

日本の技術を結集し IoT市場に新たな価値を創造し 雇用創出に貢献する

4ヶ月間世界をまわり如何に半導体で勝ち残れるかを模索しました。8年間で493千キロを自車で走り600社を超える企業を訪問。半導体後工程分野で、日本は材料・設備技術で圧倒的優位性があることを確信。これを武器に日本中の技術を組み合わせ、多くの経験豊富な人財を巻き込み、世界初を連打出来る、新たな事業、雇用創造が出来ると確信し、2009年11月創業。志を同じくする大手電機メーカー出身者が集結しています。

【PROFILE】

1964年生まれ
新潟県立直江津高校卒業
松下電子工業(株)(現パナソニック(株))

【創業年】 2009年

・人体影響の大きい鉛を電子電気製品から取り除く鉛フリーを世界ではじめて提唱。パラジウムめっきを使用した。半導体パッケージQFPを世界で初めて導入し業界の鉛フリー展開に貢献。プロセス改善に伴い大幅なコストダウンにも成功。
・超微小パッケージ技術、CSP事業化を世界で最初に事業化に成功する。

【座右の銘】 粗にして野だが卑ではない(石田禮助)

会社の特徴

『変える力』と『つなぐ力』で IoT実装に革命を!

当社の開発陣は大手電機メーカーで長年技術開発を主導してきたエンジニアが主体です。世界の半導体を牽引してきたエンジニアが集まったことで関連する技術のハブ機能を果たすことが可能となります。MonsterPACをコアとした実装技術開発を軸に事業プロデュース、プロモートできることが当社の強みです。社名の由来通り人と人、技術と技術、企業と企業を結び、『変える力』と『つなぐ力』で世界初に挑戦し続けています。



▲希望は過去にあり戦う理由は、未来にある

事業・サービスの強み

IoT時代における多品種変量生産市場の受託開発 Only Oneプレーヤー

従来のはんだ実装では不可能な多様なデバイス、基板材料への実装を当社独自のMonsterPAC Technologyで実現します。80℃-170℃の極低温・低荷重の実装プロセスはIoTアプリケーションの材料選択の幅を広げ、市場を爆発的に広げます。また、従来比1/10にプロセス短縮を実現したMonsterデスクトップファクトリー実現。あらゆるお客様の『やりたい』を実現いたします。

7つの『世界初』に挑戦

- ① MONSTER PAC® 80-170℃ FCB実装
- ② OSRDA 実装受託開発製造ビジネスモデル
- ③ MONSTER DTF® デスクトップファクトリー
- ④ MONSTER PAC® 10ミクロンピッチFCB実装
- ⑤ MONSTER PAC® 80℃ PETフィルム基板FCB実装
- ⑥ 世界最小MEMSワイドレンジ圧力センサ
- ⑦ ディスプレー型、透明・大型指紋認証センサ

What's New : 日本企業初
米国FHEコンソーシアムNextFlex内R&Dライン開設

▲7つの世界初